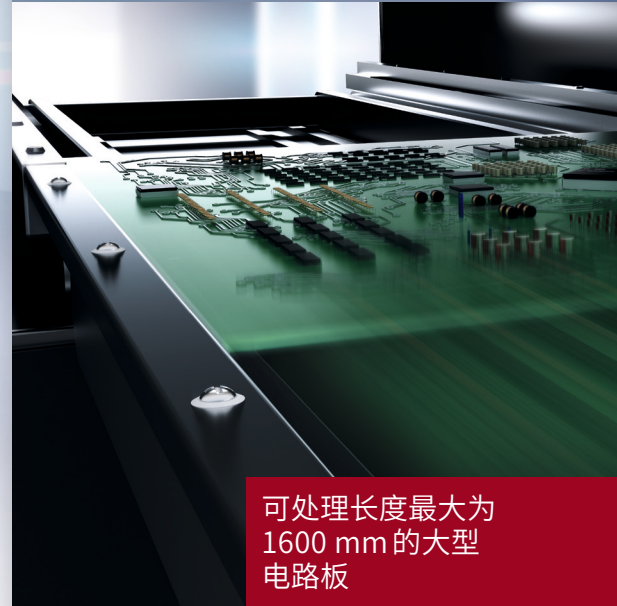




极具前瞻性的  
3DX光系统，  
实现PCBA的  
联网生产

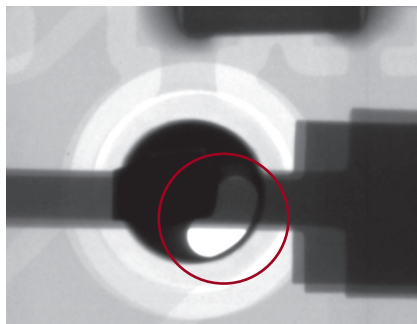


可处理长度最大为  
1600 mm 的大型  
电路板

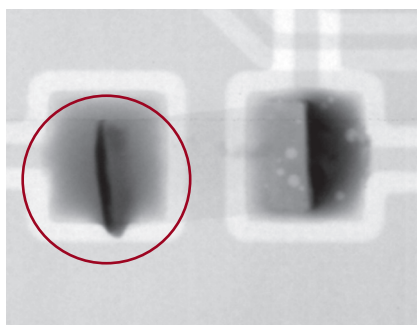
## iX7059 PCB Inspection (XL)

创新的X光检测确保最高的产品  
质量和最佳的流程效率

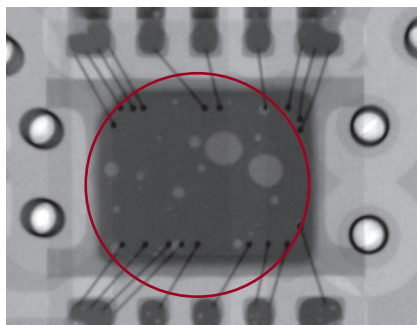
# 先进的质量保证用于现代化 电子元件制造



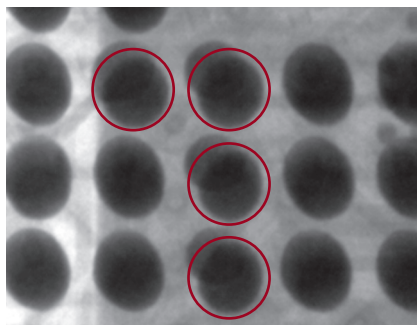
THT焊点中的空洞



处于立碑位置的SMD部件



平面焊接中的空洞



未连在一起的BGA锡珠

---

**对密集、厚实以及双面装载的印刷电路板  
进行完整的缺陷检测**

---

**流畅处理超大组件, 例如, 服务器主板、  
LED应用、半导体和5G电子元件**

---

**高精度焊锡连接点检测, 也适用于  
高性能处理器的最小部件和复杂组件**

---

**测量表面焊接中的气孔以确保高效的热传导**

---

**对THT焊点、针脚高度和填充度进行质量检查,  
以避免短路**

---

**现代化的操作软件, 实现最快的编程  
和最简单的验证**

---

**遍及全球的服务、热线支持和远程维护**

---

除了周期时间外, 绝对可靠和全面的检测范围在生产线的质量控制中也起着决定性的作用: 因为它直接影响了工艺效率, 确保产品质量始终如一, 并杜绝废品。高精度 3D 在线X光检测可确保获得最佳的直通率结果, 此外还能够可靠地检查被遮盖的焊点连接以及带有THT、BGA、CSP、QFP、SSOP、芯片和LED的复杂组件。

iX7059 PCB 系统的创新3D X光技术得益于独特的动态3D图像采集方案, 缩短了采集时间, 同时通过内置的计算机断层扫描技术提供出色的3D层析图像, 从而实现无与伦比的测量精度和最大化的吞吐量。

## 最佳直通率结果

Viscom Quality Uplink通过3D SPI、3D AOI、3D AXI和验证站的智能联网实现最高质量和流程效率



## 无缺陷且稳定的高端电子元件生产

Viscom早已胜任在最高短期时间的生产线上进行完整3D X光检测的挑战。此外，iX7059全新的系统设计还通过24英寸触摸显示器实现了节省空间的布局、智能联网和极其简便的操作。其最大优势在于实用灵活性，可以处理长达1600mm，重达15kg的超大型电路板。

除经典的SMD检测外，iX7059 PCB Inspection (XL)检测系统还能高精度且可靠地识别焊接缺陷，例如枕头效应、BGA和LGA组件中的气孔以及表面焊接中的空洞，并检查THT焊点的填充度。这有助于诸如LED、汽车行业的安全技术以及高端电信、服务器技术等应用领域，以及可靠的功能至关重要的任何领域。

iX7059 PCB Inspection (XL)检测系统的核心是基于计算机断层扫描摄影技术(CT)的3D X光技术，可确保高速、高质量的图像采集。强大的微聚焦X光发生管、最先进的平板探测器和创新的动态图像采集相结合，实现了精确的层析图像结果，从而实现最高水平缺陷识别。

得益于全面的部件检测资料库，编程极其人性化且省时，此外凭借Viscom内置的验证功能可以自动进行优化，这特别有利于新的检测程序。由人工智能(AI)支持的验证有助于改进分类并避免占用额外的资源。Viscom的iX7059 PCB Inspection (XL)检测系统是实现最大投资回报率和无缺陷高端电子元件生产的首选，并能满足日益增长的需求。

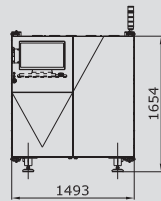


iX7059 PCB Inspection XL 系统可检测极长的印刷电路板：标配最长可达 1000 mm，带外部输送翼长度最大可达 1600 mm

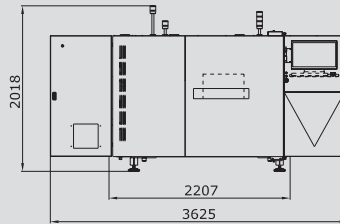
# 技术数据



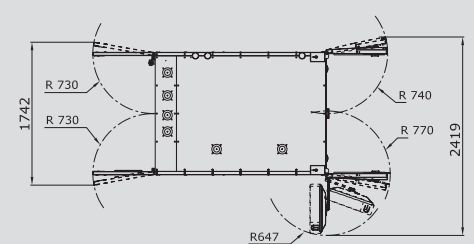
前视图



侧视图



俯视图



单位:mm

	iX7059 PCB Inspection	iX7059 PCB Inspection XL	
传感系统	X光发生管	封闭式微聚焦 X 光发生管	
	高压	130 kV	130 kV (可选配最高 180 kV)
	管电流	300 μA	300 μA (500 μA)
	探测器	平板探测器 FPD 型 T2 (选配 T3), 14 位灰阶深度	
	分辨率	8.5 - 25 μm/像素	
	3D 图像采集模式	标配 Evolution 4, 可选配 Evolution 5 实现卓越的动态图像采集	
	X光机箱	根据辐射保护法 (StrSchG) 及辐射保护法规 (StrlSchG) 的高标准高要求进行设计。 辐射泄漏率 < 1 μSv/h	
软件	操作界面	Viscom vVision/EasyPro	
	统计进程控制	Viscom vSPC/SPC, 开放式接口 (选配)	
	验证维修站	Viscom vVerify/HARAN	
	远程诊断	Viscom SRC (选配)	
	编程站	Viscom PST34 (选配)	
	操作系统	Windows®	
	处理器	Intel® Core™ i7	
处理	印刷电路板尺寸	最大 610 mm x 600 mm (长 x 宽) *	最大 1600 mm x 660 mm (长 x 宽) *
	电路板重量	最大 10 kg	最大 15 kg
	传送高度	860 - 980 mm ± 20 mm	
	宽度调整	自动调整	
	夹紧装置	气动	
	支架宽度	3 mm	
	上方净空尺寸	最大 50 mm	
下方净空尺寸	最大 50 mm		
其他系统数据	行走/定位单元	同步直线电机	
	接口	SMEGA, IPC Hermes (选配)	
	电源要求	400 V (其他电压根据要求提供), 3P/N/PE, 8 A, 4 - 6 bar 工作压力	
	系统尺寸	1493 mm x 1654 mm x 2207 mm (宽 x 高 x 长)	
	生产线集成尺寸	两侧 +30 mm, 加上带有扩展长板选项的侧边通道	
	重量	2245 kg*	

\*取决于配置

我们的国际分部和代表处请查询网站: